

# 個人投資家向け会社説明会 ミーティングメモ

## リンテック株式会社 (7966)

開催日：2026年3月8日(日)

場 所：大和コンファレンスホール（東京都千代田区）

説明者：代表取締役社長 服部 真 氏

### 1. 当社の概要

- ・ 当社は東京都板橋区に本社を構える、粘着製品や特殊紙のリーディングカンパニーです。日用品など身の回りにあるさまざまなものに貼られるシール・ラベル用粘着素材をはじめ、半導体や電子・光学関連製品などに使用される各種粘着製品、関連する機器の他、特殊紙や剥離紙・剥離フィルムなどの開発・製造・販売を手がけています。事業内容は多岐にわたりますが、各分野において日本を代表するメーカーであると自負しています。
- ・ 設立は1934年10月、今年で93年目を迎えます。2025年3月期の連結売上高は3,160億円、営業利益は246億円に達しました。世界18の国・地域において37の海外連結子会社を有し、連結従業員数は5,311人に上ります。お客さまや社会の課題解決につながる新製品、新技術の開発なども強化しており、2025年3月期は過去最高の101億円を研究開発に投じました。2026年3月期の年間配当金は1株当たり110円を予定し、2026年1月末時点の配当利回りは2.31%となっています。
- ・ 当社は1927年に切手のように水をつけてダンボールに貼る包装用ガムテープの製造を、1960年にシールやラベルの素材となる粘着紙・粘着フィルムの生産を開始しました。以降も工業分野などに粘着製品の用途拡大を図りながら、成長を遂げてきました。
- ・ 1986年には、当時では世界初の紫外線を使って粘着力をコントロールする「UV硬化型ダイシングテープ」を開発し、半導体関連分野に本格参入しました。そして、1990年に3社合併し、リンテック株式会社が誕生しています。
- ・ 1990年代以降は海外進出を本格化させ、アジア地域を中心にラベル関連製品や半導体・電子部品関連製品などの生産・販売拠点を相次いで設立してきました。この10年間においては北米市場への本格参入も果たし、一層、グローバル展開を加速させています。
- ・ 業績の推移としては、過去の経済危機の他、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大や米中貿易摩擦など不安定な経済市況に直面してきましたが、その際も営業赤字に陥ることなく推移してきました。
- ・ 直近の2025年3月期は原燃料価格や物流コストが上昇傾向にありましたが、半導体・電子部品関連製品が好調な需要に支えられたことなどもあり、過去最高の売上高、営業利益を達成しました。
- ・ 当社の製品は、食品や日用品、医療・医薬関連から半導体、光学関連分野まで、非常に多岐にわたっています。これは一つの業界の市況に左右されることなく安定的な収益を

大和インベスター・リレーションズ(株) (以下、「当社」といいます。)はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

---

---

確保できるという、当社の強みにもなっています。

- ・ 海外売上高についてです。当社は「市場のあるところで生産し、その市場で販売する」という、いわゆる地産地消、「メード・イン・マーケット」の考え方で事業のグローバル化を推し進め、競争力のあるラベル関連製品や半導体・電子部品関連製品などを世界各地の市場に投入し、拡販を図ってきました。近年は為替の円安効果があったものの、2025年3月期の海外売上高は2,018億円と、直近約10年間でおおよそ3倍に、連結売上高に占める海外売上高の比率も約64%にまで上昇しています。
- ・ 当社は株主さまへの利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置付けており、2027年3月期までは原則として減配せず、配当性向40%以上またはDOE3%をめどに配当を実施するという配当方針を掲げています。なお、過去10年以上にわたって減配はしていません。
- ・ 前期の年間配当金は業績が好調だったことから、当初予想の88円から12円増額の100円としました。今期は通期連結業績予想を踏まえ、前期から10円増額の110円と、2期連続の増配を予定し、配当性向は41.2%になる見込みです。
- ・ また、株主還元の一環として、昨年、300万株、83億円の自己株式を取得しました。今後も手元資金を勘案の上、適宜、必要性を判断して機動的に自己株式取得を実施していきます。
- ・ 当社では、適時適切な情報開示による適正株価の形成を目指して、機関投資家や証券アナリスト、個人投資家の皆さまに向けた幅広いIR活動を展開しています。機関投資家、証券アナリストさまとは前期実績で延べ311社との個別ミーティングを行っています。また、個人投資家の方には会社説明会を適宜実施するほか、株主通信やホームページのIRサイト、YouTubeの当社公式チャンネルなども通じて会社情報を発信しています。株主数は2025年3月末において9,311人と、4年前の2021年3月末比で1.5倍に増加しています。
- ・ 当社株価は日経平均株価と連動する形で堅調に推移しています。2025年4月にはトランプ関税ショックで大きく下落したものの、その後は上昇の一途をたどり、2026年1月末時点の終値は昨年4月に比べ2倍以上となりました。
- ・ また、PBRは1.3倍となっています。最近の株価は堅調でPBRは1倍を超えて推移していますが、当社では資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて各施策にこれまで注力してきました。収益性や資本効率アップによるROEの向上に努めるほか、株主さまとの建設的な対話やIR活動の強化、さらにはサステナビリティ経営の推進などにも引き続き積極的に取り組むことで、継続的なPBR1倍超えを目指していきます。

## 2. 製品・技術、各事業部門の概要

- ・ ここからは当社の主力製品であるラベル用粘着製品の基本構成についてご説明します。
- ・ 一般的に粘着製品は、表面基材である紙やフィルムと粘着剤、それを保護するための剥

---

---

大和インベスター・リレーションズ(株) (以下、「当社」といいます。)はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

---

---

離紙、または剥離フィルムの3層構造になっています。シールやラベルの用途によっては表面の紙やフィルムに印刷・印字適性や耐久性などの機能性を付与するための表面加工が施されます。当社では、粘着剤の設計・配合から紙・フィルムへの粘着加工や表面加工、さらには、剥離紙・剥離フィルムの生産までトータルに自社の技術で対応しています。

- ・ 1990年の四国製紙、創研化工との3社合併により、剥離紙・剥離フィルムの製造が可能になり、粘着剤や表面基材を含めた粘着製品の一貫生産体制が実現しました。また、粘着製品の特徴を最大限に引き出す、製品を貼り付けたり剥がしたりする関連装置も当社が開発・生産しており、粘着素材と関連装置をあわせて提供できる点も当社の大きな強みの一つといえます。
- ・ これまでの歴史の中で培ってきた当社の主な基盤技術は、粘着応用技術、表面改質技術、システム化技術、特殊紙・剥離材製造技術の四つに集約されます。これらの技術を応用・融合し、数多くの製品を開発・提供しています。こうした幅広い事業領域を製品や技術、市場の類似性に基づいて三つの事業セグメントに分類。各セグメントにおいては二つの事業部門、合計6事業部門体制で展開しています。

#### 【印刷情報材事業部門】

- ・ 各事業部門の概要をご説明します。まず印刷情報材事業部門は、当社の主力製品であるラベル用の粘着紙・粘着フィルムを製造・販売しています。2025年3月期の当事業部門の売上高は全体の46.4%を占める1,467億円となっています。
- ・ 当社で製造した粘着紙・粘着フィルムをシール・ラベル印刷加工会社さまに販売し、そこで印刷加工されたものがエンドユーザーに納品されます。最終的な用途は幅広く、皆さまが日常生活のさまざまなシーンで目にするラベルが実は当社の製品ということも珍しくはないかと思えます。国内市場において粘着紙では約30%、粘着フィルムでは約60%のシェアを誇る国内トップメーカーです。
- ・ 当社の粘着紙・粘着フィルムは、食品などのパッケージに貼られるラベルや宅配便の伝票、あるいは自動車内部や家電製品自体に貼られるラベルなど、さまざまなところで使用されており、それぞれ耐水性や耐熱性など用途に応じた性能を持っています。
- ・ 食品・飲料関連や流通・通販関連では、ベースとなる表面基材に紙が多く採用され、それ以外の用途ではフィルムが使用される傾向があります。どのようなものに貼られ、どれくらいの期間、どのような環境下で使用するのか。当社ではさまざまな条件に合わせて、粘着製品の基本構成である表面基材、粘着剤、剥離紙・剥離フィルムをそれぞれ選定し、無限大の可能性の中から最適な組み合わせのラベル素材を提供しています。
- ・ 海外市場においては、中国、タイ、インドネシア、シンガポールをはじめとしたアジア地域のほか、北米や欧州などの拠点を軸に事業展開を図っています。当事業部門の海外売上高比率は71.6%となっています。

- 
- ・ 米国マックタック・アメリカ社は、この印刷情報材事業部門の主力グループ会社です。米国オハイオ州において1959年に創業し、ラベル用粘着紙・粘着フィルムなどの製造・販売を行い、従業員数は1,000人を超えます。世界のラベル用粘着紙・粘着フィルム市場の約2割を占める北米市場において、マックタック・アメリカ社は第3位のメーカーで、同市場への本格参入を目的に当社が2016年に約340億円で買収しました。買収に伴うのれんの費用は約300億円に上りますが、2026年12月期をもって償却が完了する予定です。
  - ・ また、当社では2024年までに追加で累計約180億円を投じ、マックタックグループの生産能力や販売網の拡充などを主眼に、積極的なM&Aを実施してきました。マックタック・アメリカ社はリンテックグループにはなかった、熱で溶かして塗工するホットメルト粘着剤という、環境にも配慮した優れた処方技術を有しており、両社間で技術面での相乗効果も発揮してきました。

#### 【産業工材事業部門】

- ・ 印刷情報材事業部門と同じセグメントの産業工材事業部門では、建物や自動車の窓ガラスに貼ることで、ガラス飛散防止効果や遮熱機能による省エネ効果などを発揮するウインドーフイルムのほか、街中で見かける耐久性に優れた屋外看板・広告用フィルム、内装用化粧フィルム、そして自動車用などの工業分野を中心に幅広い市場に粘着製品を展開しています。2025年3月期の当事業部門の売上高は全体の12.0%、380億円、海外売上高比率は52.6%となっています。
- ・ 近年は米国や東南アジアを中心に、建物や自動車用のウインドーフイルムなどの販売が好調に推移しており、この分野におけるビジネス領域を拡大させています。
- ・ また昨今、国内においては闇バイトによる強盗事件が社会問題となっており、当社の建物用ウインドーフイルムでは防犯対策効果のある製品が注目されています。そのほか、物流の現場などで、配送ラベルを自動で貼り付けるラベリングマシンなども手がけ、インターネット通販市場の拡大のほか、労働力不足の解決や生産効率の向上により需要が増加しています。

#### 【アドバンストマテリアルズ事業部門】

- ・ 電子・光学関連のアドバンストマテリアルズ事業部門では、半導体チップの製造工程で使われる特殊粘着テープと関連装置、そして積層セラミックコンデンサ関連テープなどの開発・製造・販売を行っています。近年の当社の成長をけん引する部門で、2025年3月期の当事業部門の売上高は全体の26.9%、850億円となっています。
- ・ 半導体の製造工程は大きく前工程と後工程に分かれ、当社の半導体関連製品が使用されるのは主に後工程です。
- ・ まずウェハ裏面を薄く削る工程において、表面の回路面を保護する役割を担う表面保護

---

テープがあります。昨今、ウェハの薄型化が進むとともに当社の表面保護テープの品質や性能が市場で高く評価され、高いシェアを有しています。また、ウェハを薄く削る工程の後、ウェハをチップに切断するダイシングと呼ばれる工程で使用されるのがダイシングテープです。このテープは、ダイシング時には強い粘着力で確実にチップを保持し、ダイシング後はUVを照射することで粘着力を低下させ、個片化した半導体チップを効率よくピックアップすることができます。

- 当社は1986年、このUV硬化型ダイシングテープで半導体関連事業に本格参入しましたが、UV照射技術によって、特にハイエンド向けに強みを有しており、市場ではトップクラスのシェアを誇っています。
- また、当事業部門では高機能スマートフォンやパソコンといった電子機器などに搭載される積層セラミックコンデンサという、電子部品の製造工程で使われる高品質な剥離フィルムを提供しています。最近では特にAIデータサーバー用途の需要が高く、出荷量が増加しています。先ほどご説明した半導体関連製品とともに、今後も需要の増加を見込んでいます。
- 当事業部門には海外の販売子会社が多くあり、海外売上高比率は74.5%と高い水準になっています。
- 世界の半導体市場は自動車用途や一般産業用途に弱さが見られるものの、AI需要を見越したデータセンター投資などが連動する形で、メモリー製品やGPUなどのロジック製品が成長を主導しています。
- 主要な半導体メーカーで構成するWSTS（世界半導体市場統計）は2025年12月、2026年の世界半導体市場が前年比26.3%増の9,755億米ドルに拡大する見通しを示しました。米国の関税政策に端を発する貿易摩擦などが地政学リスクとして懸念されるものの、引き続きAIが市場のけん引役を担い、世界の半導体市場はますます成長することが予測されており、当事業部門としても成長が期待されます。
- なお、AIの急速な需要拡大が進む中、AIに必要不可欠な半導体としてHBMが注目を浴びています。HBMとは記憶をつかさどるメモリー半導体で、非常に高い帯域幅を持ち、高速・大容量のデータ処理が可能です。HBMはメモリーの一つであるDRAMを積層して作られますが、当社はそのDRAMを積層する工程で使用されるテープを貼付する装置も手がけており、複数の半導体メーカーに採用されています。特に2025年3月期はこのHBM向け装置について高水準の受注をいただき、同装置を含めた半導体関連装置が各種半導体関連粘着テープとともに当社の収益に大きく貢献しました。
- これら後工程で使用される製品以外にも、事業領域を拡大するべく、前工程で使われる新しい部材の開発にも乗り出しています。当社がかねてより米国の研究開発拠点において、カーボンナノチューブという素材のシート化技術と用途展開について研究してきましたが、そのカーボンナノチューブを用いて半導体製造の前工程でフォトマスクの防じん膜として使われるペリクルと呼ばれる材料の研究開発に成功しました。

- 
- 
- ・ カーボンナノチューブ製ペリクルは、微細化が進む回路の露光機に求められる高い耐久性を満たしており、量産化の確立に向けた取り組みを鋭意進めています。

#### 【オプティカル材事業部門】

- ・ 同じく電子・光学関連のオプティカル材事業部門では、スマートフォンやタブレット、テレビなどの光学ディスプレイ向けの粘着製品や、車載用タッチパネル向けの粘着製品などを手がけています。2025年3月期の当事業部門の売上高は全体の3.6%、113億円となっています。
- ・ 当事業部門では光学ディスプレイを構成するフィルムを貼り合わせるための関連粘着製品の展開のほか、ディスプレイ表面の反射防止や傷をつきにくくするための表面加工などを行っています。これらの製品には当社独自の精密コーティング技術と先端のクリーンルーム設備が最大限に生かされています。
- ・ 他にも、自動車のタッチパネルの貼り合わせに使用される高機能光学両面粘着シートを展開しているほか、スマートウォッチなどに使用される光拡散フィルムなど、高品質・高性能なデジタル機器の生産に貢献する製品の拡販にも注力しています。また、電子ペーパーに使われるガスバリアフィルムも手がけており、現在「ペロブスカイト太陽電池」への採用に向けた開発や提案も進めています。

#### 【洋紙事業部門】

- ・ 洋紙・加工材関連の洋紙事業部門の、2025年3月期の売上高は全体の4.7%、149億円となっています。豊富な色数が特徴のカラー封筒用紙や色画用紙、高級印刷用紙など、数多くの特殊紙製品をラインアップしています。
- ・ 近年ではデジタル化やペーパーレス化、郵便料金の値上げ等により、本事業の市場環境は大変厳しい状況です。一方で、昨今の環境配慮意識の高まりから、食品包装資材や文具、日用品などさまざまな用途で脱プラスチック・減プラスチック需要が拡大する中、当社特有の製紙技術による製品の可能性が高まっています。当社では耐油性や耐水性、透明性などにおいて、プラスチックやフィルムに近い性能・機能を備えた特殊機能紙を各種開発し、プラスチック代替製品として提案を強化しています。

#### 【加工材事業部門】

- ・ 加工材事業部門の2025年3月期の売上高は全体の6.4%、201億円となっています。当事業部門では、剥がす技術を応用した各種製品を展開しています。具体的には、シール・ラベル用などの各種粘着製品の粘着剤を保護するための剥離紙や、液晶ディスプレイなどの光学関連製品に使われる剥離フィルム、その他、電子材料用途で使われる製品として、配線基板であるFPCの表面を保護するカバーレイと呼ばれる絶縁フィルム用の剥離紙などがあります。

- 
- 
- ・ さらには、合成皮革や炭素繊維複合材料の製造時に使われる工程紙と呼ばれる製品もラインアップしているほか、各種工業用にも当社独自の剥離製品がポジションを確立しています。

#### 【パーパスブランド「Welsurt（ウェルサート）」】

- ・ 当社では、各事業で培ってきた独自の粘着技術や剥離技術、抄紙技術などに新たなテクノロジーを融合し、環境・社会に関する課題の解決を目指した新たな価値創造につながる動きも強化しています。具体的には省エネルギーや創エネルギー、海洋資源保全、情報通信・エレクトロニクス、モビリティ、医療・介護といった分野を中心に、新製品・新事業の創出を目指し、2022年7月には、これらの各開発テーマについて「Welsurt（ウェルサート）」という新しいパーパスブランドを立ち上げ、技術開発と社外への技術提案を強化しました。持続的成長に向けた、こちらの取り組みにもぜひご期待ください。

### 3. 2026年3月期連結業績予想

- ・ 2026年3月期においては、期初に発表された米国政府の関税政策による世界経済への影響、地政学リスクの高まり、各国の金融政策による為替変動など、当社グループを取り巻く経営環境は非常に不透明な状況が続いています。また、原燃料や輸送コストの上昇、人件費や新規生産設備の導入による減価償却費などの固定費増加が利益の押し下げ要因になると考え、本年度の業績予想は昨年5月に公表したものから変更していません。

### 4. 長期ビジョン、中期経営計画

- ・ 長期ビジョン「LSV 2030」については、イノベーションによる企業体質の強靱化と持続的成長に向けた新製品・新事業の創出を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献することを基本方針としています。また重点テーマとして、社会的課題の解決、イノベーションによる企業体質の強靱化、持続的成長に向けた新製品・新事業の創出の三つを掲げ、各施策に積極的に取り組んでいます。最終年度である2030年3月期の財務目標は、売上高営業利益率12%以上、ROE10%以上を目指していきます。
- ・ 当社グループでは、長期ビジョンとして2030年のあるべき姿をしっかりと描き、その実現に向けたマイルストーン（中間目標）として3年ごとの中期経営計画を策定・推進しています。現在は2024年4月からスタートした中期経営計画「LSV 2030-Stage 2」の2年目に当たり、4月から最終年度を迎えます。
- ・ 当初に掲げた経営目標について、売上高は前期2025年3月期に前倒しで達成することができました。すべての経営目標を達成できるよう、全社一丸で取り組んでいきます。
- ・ 中期経営計画「Stage 2」期間中は、累計で約1,300億円のキャッシュフローを見込み、そのうち設備投資に約600億円、研究開発に約320億円を計画し、M&Aなどの機動的投資について検討するほか、株主還元の充実も図っています。

- 
- 
- ・ 設備投資については、前中計期間から半導体・電子部品関連製品などの需要増加に対応する体制整備を進めてきました。半導体関連粘着テープや積層セラミックコンデンサ関連テープの生産設備の増設を前倒しで進め、旺盛な需要に応えられる体制を構築しています。
  - ・ また、半導体関連装置についても、中長期的に高い需要が見込めることから、装置の開発・製造を担う伊奈テクノロジーセンターの再構築に乗り出すなど、前期の設備投資額は期初計画を上回る 206 億円となりました。研究開発費は、前期に過去最高の 101 億円を投じました。新製品・新事業への投資を進めており、EUV 露光機用 CNT ペリクルなど、半導体関連について重点的に先行投資を行っています。

## 5. まとめ

- ・ 前期は売上高、営業利益ともに過去最高を達成しましたが、今期は増収減益予想ではありますが、前期とほぼ同水準の業績を見込んでいます。
- ・ また、事業のグローバル展開を積極的に推進しており、市場成長が見込まれる海外でグローバルネットワークを構築しています。海外売上高比率は約 64%にまで上昇しています。
- ・ 過去 10 年以上にわたって減配はしておらず、2 期連続での増配を予想しています。
- ・ 最後に、半導体関連事業が当社の成長をけん引しており、半導体製造の後工程で 사용되는粘着テープや装置の開発だけでなく、ペリクルといった新しい製品をひきさげて前工程という新規領域の開拓にもチャレンジしていきます。

## 6. 質疑応答

- Q1. 現在の 6 事業の中で、中長期的に最も成長が期待できる事業はどれだとお考えでしょうか。
- A1. アドバンストマテリアルズ事業です。世界の半導体市場は AI 需要の増加によるデータセンターなどへの旺盛な投資により、前年比二桁増の成長が続いており、WSTS の市場統計も 2026 年に 1 兆ドル規模に拡大します。その中であって、当社が今まで地道に築き上げてきた半導体関連のビジネスなどの中長期的な成長は、引き続き強力に進んでいくものと思っています。そのための積極的な投資も進めています。

以上